

# 低シリコーン剥離フィルム

# HP-S0/HP-S0A

## 特長

低シリコーン剥離処理フィルムで、さまざまな基材に処理することができます。シリコーン系と同等の剥離性能を持ち、耐熱性にも優れた特性があります。

## 構成



## 物性データ

項目	単位	代表値
剥離力【31B法】	mN/25mm	100
接触角	degree	105

## 剥離力 測定方法

テープ : 日東No.31B  
速度 : 0.3 m/min  
角度 : 180°  
条件 : 常温で20時間放置後の剥離力（セバ剥離）

※ 上記の数値は代表値であり、保証値ではございません。

※ 上記の数値は、75 μm品で測定しております。

 株式会社フジコー

0877-28-6111  
FAX 0877-28-6114

〒763-0092 香川県丸亀市川西町南甲 284番地2

